

半導体製造装置フィールドアプリケーションエンジニア（メカ）

TOWA株式会社での募集です。 製造技術（機械）のご経験のある方は歓迎です。

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
TOWA株式会社

求人ID
1625047

業種
機械

雇用形態
正社員

勤務地
京都府

給与
500万円 ~ 700万円

勤務時間
08:30 ~ 17:30

休日・休暇
【有給休暇】初年度 10日 1か月目から 年間123日（＋一斉年次有給休暇取得日2日）週休2日制（基本土日祝、弊社カレンダー…

更新日
2026年11月26日 16:14

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
専門学校卒

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2276576】
半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア（メカ）として、お客様との密なコニュニケーションを通した技術サポートを担っていただきます。具体的には、装置の導入支援や生産時のカスタマイズや技術サポートにおいて、技術的なコミュニケーションを通じて得るお客様のニーズや課題を開発部門にフィードバックし、新製品・新機能の提案を行います。お客様と信頼関係を深め、専門知識や折衝能力を高めることで、将来的にはプロジェクトリーダーや技術スペシャリスト、マネージャーとしてご活躍いただけるステージがございます。

お客様の工場に設置する半導体製造装置の導入支援
お客様のニーズから新しい機能の提案

開発部門へのフィードバック
お客様への技術トレーニングの実施

スキル・資格

＜必須＞
自動機（FA）の知見・設計経験・立ち上げ経験のいずれかをお持ちの方
協調性、自主性と責任感があり、チームで成果をあげる働き方に魅力を感じる方
技術英語（初級）
＜歓迎＞
半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア経験
装置の設置・調整・トラブルシューティング経験
機械工学、電気電子工学、物理学等の一般知識
技術的な問題解決能力
技術英語（中級以上）
＜求める役割＞
お客様との信頼関係を大切に、お客様のニーズや技術的な課題解決を的確に捉え、粘り強く課題解決に取り組み、最適なソリューションの提供に価値を感じる方。現状に留まることなく常に進化を追求し、新しい知識や技術の習得に意欲的な方。

会社説明

【半導体事業】半導体製造装置（モールディング装置・シンギュレーション装置）・超精密金型の開発・製造・販売【化成品事業】ファインプラスチック成形品の製造・販売【新事業】超精密加工技術をコアとした商品の発売【レーザー事業】レーザー加工装置の販売